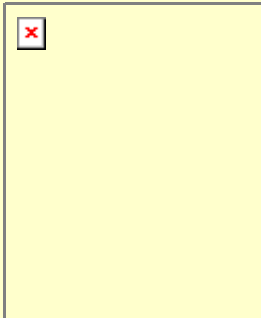


本期封面



1999年7期

栏目:

DOI:

论文题目: 镶嵌晶粒和晶界对铜双晶体循环变形行为的影响

作者姓名: 张哲峰 胡运明 王中光

工作单位: 中国科学院金属研究所材料疲劳与断裂国家重点实验室, 沈阳 110015

通信作者: 张哲峰

通信作者Email: zhfzhang@imr.ac.cn

文章摘要: 比较了含镶嵌晶粒铜双晶体及其基体单晶体的循环变形行为, 结果表明, 双晶体的循环应力总是高于基体单晶体, 结合表面滑移形成貌饱和位错组态, 分别讨论了镶嵌晶粒和环绕晶界对双晶体循环变形行为的影响.

关键词: 铜双晶体 循环变形 镶嵌晶粒 晶界

分类号: TG146.11 TG111

关闭